

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年12月11日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	长城证券 邹兰兰、红思客资产 杨岌、红思客资产 赵吉星、知远投资 王兵、深圳振华 庞世聪、都宜私募 陈辉、华润银行 郭常林、银河证券 杨权、三企投资 俞伟峰、个人投资者 周伟、中信证券 郑凯航、高毅资产 罗晓迪、浑元资产 项凯、鸿道投资 方云龙、运舟资本 廖浚哲、上海崇山投资 欧阳亦轩、浙商资管 谢艺菲、全天候基金 蔡淇丞、中信证券 丁科翔、汇添富基金 李云鑫、洲和资本 马腾、金鹰基金 何欢、银华基金 薄官辉、正圆投资 廖茂林、旭辉资产 王驰、谢诺投资 徐平龙
会议时间	2024年12月11日 10:30-11:30 2024年12月11日 16:30-17:30
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	战略部总监兼投资者关系负责人 肖博天 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司如何展望企业级存储的市场空间？公司有哪些产品可以应用于企业级存储领域？ A1: 据 IDC 预测，2024-2028 年中国企业级存储市场预计将保持稳健的增长态势，预期复合年增长率达到 4.7%。公司企业级存储可分为 SATA SSD、PCIe SSD、CXL 内存及 RDIMM 内存条四大类产品，其中，公司企业级 SP506/516 系列 PCIe5.0 SSD 荣获了存储风云榜“2024 年度企业级固态硬盘产品金奖”。未来，公司将着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作，赋能 AI+时代的数智化升级。</p> <p>Q2. 公司 2024 年前三季度现金流量大幅好转的原因是什么？ A2: 2024 年前三季度，公司实现经营活动产生的现金流量净额为 4.95 亿元，同比增长 127.09%。公司经营活动产生的现金流量净额增幅较大主要系公司大力发展国内外一线客户，销售量及销售额大幅提升所致。</p> <p>Q3. 公司的自研主控芯片有哪些竞争优势？ A3: 公司积极布局芯片研发与设计领域，目前公司第一款 eMMC（SP1800）国产自研主控已完成批量验证，性能优异。作为国产自研的 eMMC 主控芯片，SP1800 以其领先的技术实力，为用户提供了更高性能、更可靠的存储解决</p>

方案。SP1800 支持 eMMC5.1 协议，支持 QLC 颗粒，采用创新架构设计以及 4K LDPC 算法和 SRAM ECC 纠错功能。SP1800 以领先的性能、高纠错能力和高度的兼容性重塑了 eMMC 存储新标准，实现了高性能与低功耗的完美平衡，将为终端用户带来更加高效、安全的存储体验。

Q4. 公司在 AI 端侧领域有哪些业务布局和竞争优势？

A4: 公司在受 AI 驱动的大容量闪存和内存产品布局上比较全面，满足 AI 端侧设备对存储配置提升的需求。在智能手机领域，随着 AI 大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧 AI 的能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于 AI 手机的发展；在产品方面，公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 产品。在 PC 领域，AIPC 基于大模型的算力需求，对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求；公司面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被 Google、Meta、小天才等知名企业应用于其智能手表、VR 眼镜等智能穿戴设备上；基于公司研发封测一体化的布局，公司产品在可穿戴领域具有较强的竞争优势，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力。

Q5. 公司目前的研发人数有多少人？研发投入是多少？重点投入的研发方向有哪些？

A5: 截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量达到 750 人，较上年同期增加 277 人，同比增长 58.56%；公司研发人员数占公司员工总数量的 37.73%，同比增加 4.04 个百分点。2024 年前三季度，公司研发投入为 3.39 亿元，同比增长 123.63%，研发费用占公司营收比例为 6.74%。公司持续加大芯片设计、解决方案研发、先进封测及存储测试设备等领域的研发投入力度。

Q6. 高品质 DDR/LPDDR 产品对存储厂商测试能力要求很高，公司是否具备相关测试能力？

A6: 公司在 2022 年引进全球领先的 Advantest（爱德万）T5503HS2 量产测试系统，与公司自研的全自动化测试设备相结合，进一步强化了公司全栈存储芯片测试能力，结合丰富的自研测试算法库，可以对 DDR5/LPDDR5X 等高端芯片进行全面的特性分析，保证产品品质，并达到客户要求的高性能指标。在市场方面，公司 LPDDR 系列产品已进入多家消费电子龙头企业的供应体系。

Q7. 公司在 PC 前装市场有哪些竞争优势？

A7: 针对 PC 品牌商、PC OEM 厂商、装机商等 PC 前装市场，公司佰维（Biwin）品牌提供的产品主要包括消费级固态硬盘及内存条，产品具有高性能、高品质的特点，符合 To B 客户的高标准要求。另外，公司能提供稳定的供货保障和完善的售后。凭借长期的技术研发积累和智能化的生产测试体系，公司产品通过了 PC 行业龙头客户严苛的预装导入测试，在性能、可靠性、兼容性等方面达到国际一流标准，目前已经进入联想、宏碁、同方、富士康等国内外知名 PC 厂商供应链。

	<p>Q8. 公司目前的存货策略是怎样的？ A8：自 2024 年以来，公司采取较为中性的备货策略，以销定采。公司预计将继续保持以销定采的备货策略。</p> <p>Q9. 公司在先进封测领域有哪些前瞻性的布局？ A9：公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从 2010 年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平；公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级先进封测能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，服务公司客户对于存算合封业务的需求，为相关客户提供封测服务。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 12 月 11 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。